

用于通讯/数据中心 光通信设备的高性能材料



目录

光学系统材料解决方案4

- 热管理
- 防护
- 粘接

光模块组装产品分类6

- 单模光模块材料解决方案
- 多模光模块材料解决方案
- 波长选择开关WSS材料解决方案
- 可重配置波分复用ROADM材料解决方案

光模块组装材料解决方案10

- 粘接材料
- 保护材料
- 导热材料

线缆与连接器材料解决方案24

- 低压注塑材料

汉高赋能 下一代AI数据中心

凭借优异的导热性能、机械稳定性以及高可靠性，汉高材料能够支持AI工作负载所需的高速数据传输和高能效运行。

针对高功率密度的800G及新兴1.6T光模块、相干光模块、超高密度可插拔光模块、近封装光学、以及共封装光学等应用的严苛要求，汉高先进的电子胶粘剂、热界面材料和防护材料能够提升性能并确保可靠性。

电缆与连接器

光通信组件的可靠性与性能，和连接它们的线缆及连接器的坚固程度紧密相关。

汉高低压注塑材料可以降低接口应力、抵御湿气和环境污染物，可加固网络连接，减少维修或更换的需求。

汉高的低压注塑和灌封解决方案产品组合，专为实现更快的生产节拍、更高的耐久性以及与多种基材的良好兼容性而开发。

光学系统材料解决方案

热管理

支持AI应用的光学系统具有较高的发热量，因此热管理是实现性能优化最关键的因素之一。

电子元器件集成度持续提高，高性能、小型化的器件已经成为行业常态。新一代光模块为了满足更高的数据传输需求，需要消耗更多功率，从而产生更大的热负荷。

汉高提供多种形式的界面材料，具备：

- 优异的导热性能
- 灵活的工艺适应性
- 对精密光学器件施加更低装配应力

这些优势有助于满足先进光电子系统的散热需求。



防护

汉高针对光模块和光学器件提供全面的防护材料产品组合，包括：

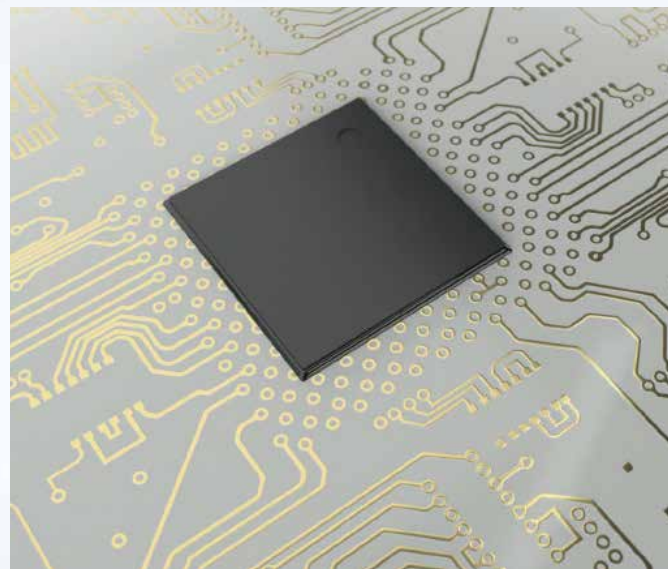
- 底部填充胶
- 封装材料
- 低压注塑材料

这些材料能够有效抵御机械应力和振动。

此外，汉高还提供

- EMI电磁屏蔽材料

用于降低信号干扰，保障系统稳定运行。



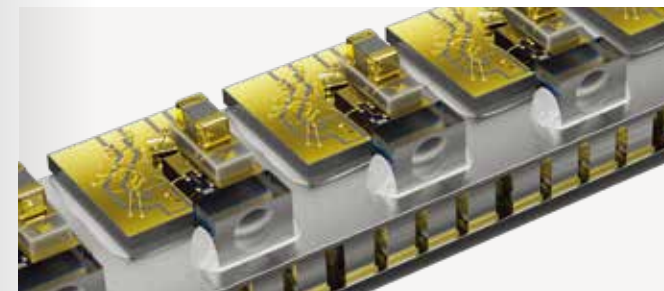
粘接

AI数据中心中的光互连设备必须将尽可能多的光能耦合进入光纤，以实现高速、高完整性的数据传输。

汉高提供覆盖以下应用的胶粘剂产品组合：

- 芯片粘接胶
- 结构胶
- 主动耦合胶
- 光路胶

这些产品能够提供优异的工艺适应性、装配精度以及长期可靠性。



芯片粘接胶

用于实现激光二极管的高强度芯片固定。

汉高创新型芯片粘接材料提供多种配方和形式，在保证高性能的同时兼顾成本竞争力。



结构胶

不仅提供机械支撑，还能形成致密的防护层，防止湿气，灰尘等侵入，同时吸收热膨胀或机械冲击带来的应力，避免元件因应力集中而开裂/脱胶。适用于：

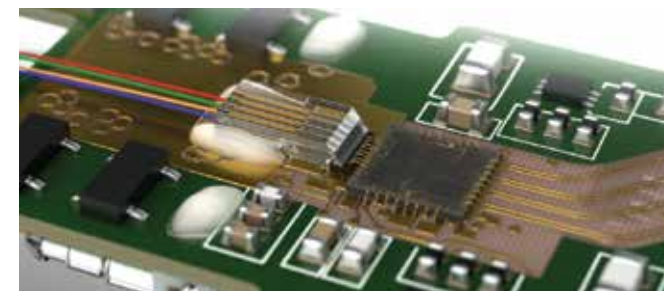
- 壳体粘接
- 元件和热沉的粘接
- PEI透镜粘接
- 热沉和PCB粘接



主动耦合胶

专为光学元件精准耦合而设计，并通过以下特性帮助实现最佳光信号强度：

- 低收缩率
- 低热膨胀系数



光路胶

光路胶为光固化材料，并具有匹配的折射率，可提高生产效率，降低光功率损耗，适用于：

- 光纤
- 各类光学器件
- 光纤阵列单元

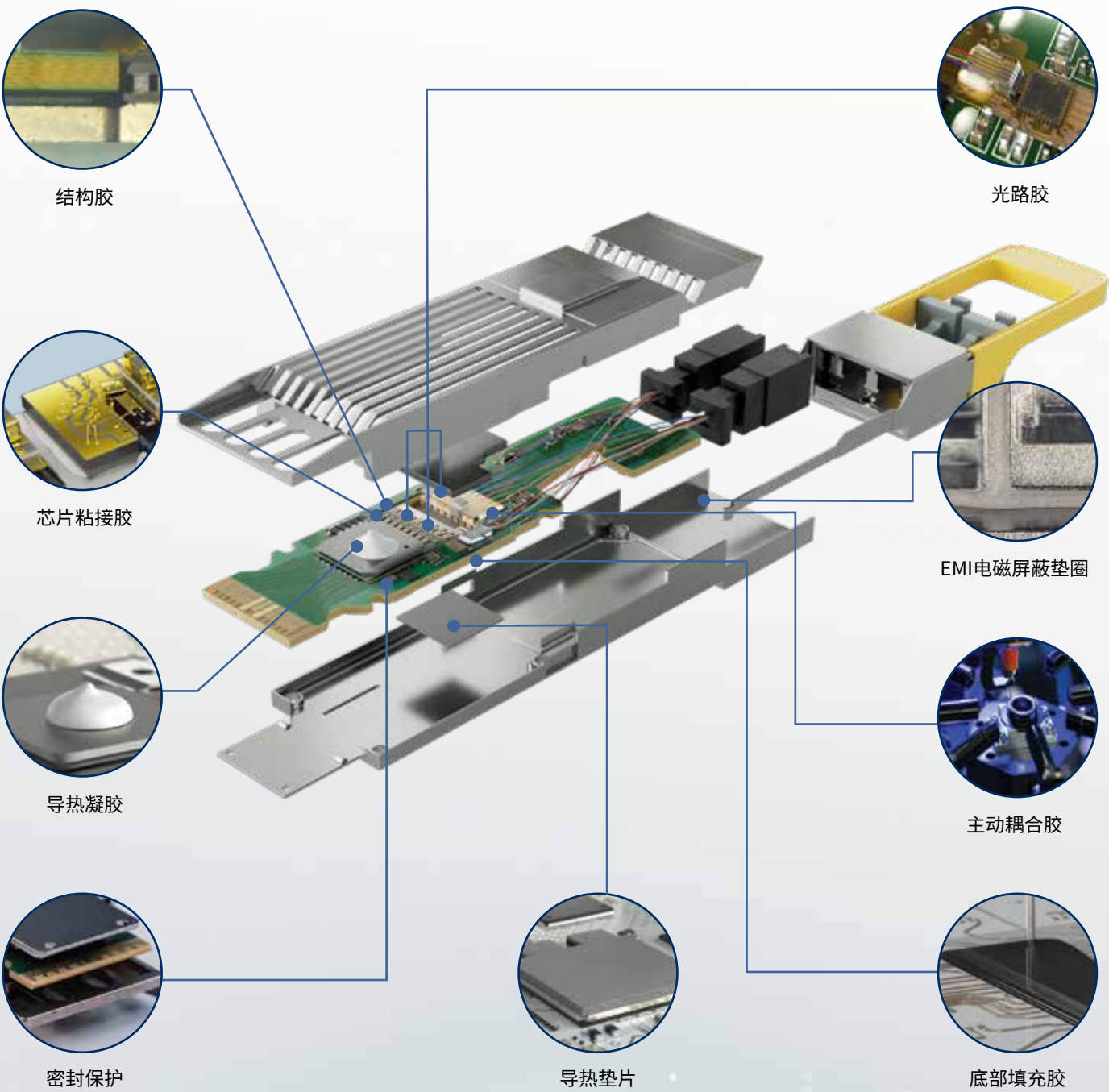
汉高光学胶粘剂的核心特性

所有汉高光学胶粘剂均经过优化，以实现最高光透过率，并兼具以下关键性能：

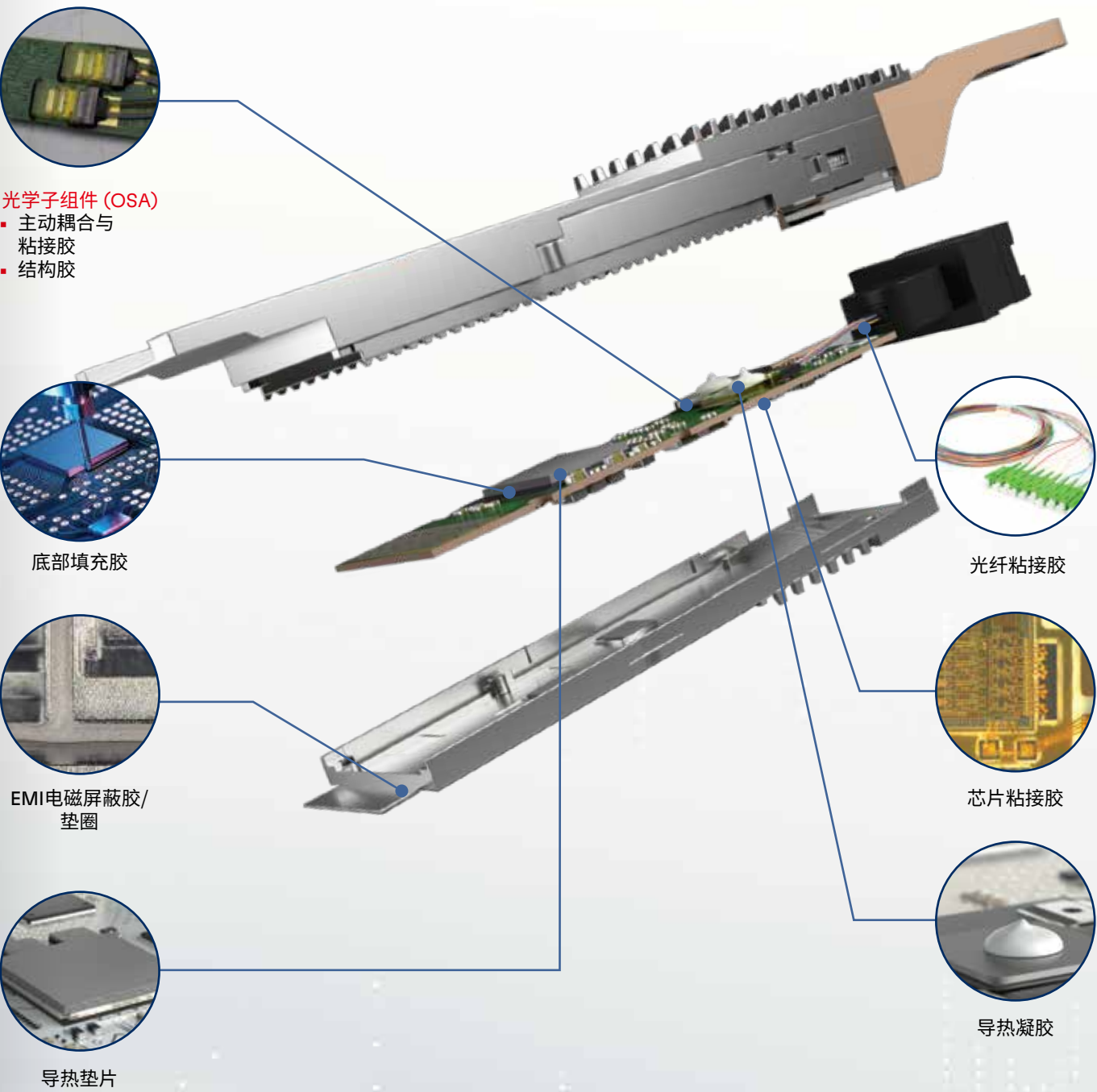
- 高粘接强度
- 固化收缩率低
- 低热膨胀系数
- 折射率匹配
- 低挥发析出
- 优异耐湿性能

光模块 组装产品分类

单模光模块材料解决方案



多模光模块材料解决方案

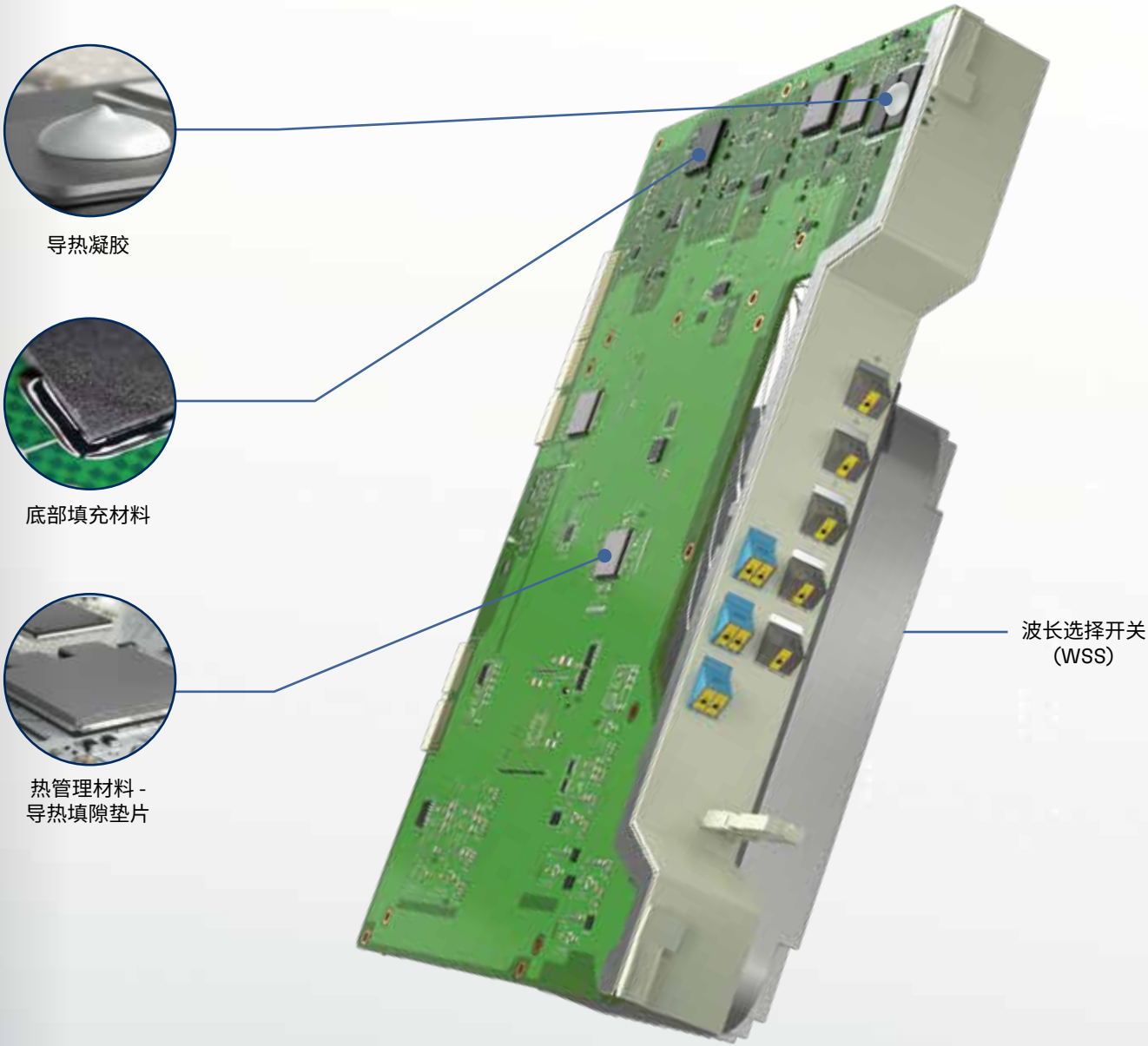


光模块 组装产品分类

波长选择开关WSS材料解决方案



可重配置波分复用ROADM材料解决方案



光模块组装材料 解决方案

光模块产品组合

🔧 粘接材料							
主动耦合胶	LOCTITE® STYCAST OS 5106	LOCTITE® ECCOBOND UF 3711	LOCTITE® ABLESTIK NCA 3216AC	LOCTITE® 3217	LOCTITE® ECCOBOND LUX 3042M	LOCTITE® HDD 4042	
芯片粘接胶	LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMI	LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMISR4	LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMISR9 new	LOCTITE® ABLESTIK 2030SCR	LOCTITE® ABLESTIK QMI 529HT	LOCTITE® ABLESTIKABP 6395TC	
	LOCTITE® ABLESTIK 8068TH	LOCTITE® ABLESTIK ABP 8920TCNP	LOCTITE® ABLESTIK 84-3	LOCTITE® ECCOBOND ABLESTIK 2025DNP	LOCTITE® ABLESTIKTE 3530		
光路胶	LOCTITE STYCAST OS 5151 new						
结构胶	LOCTITE® STYCAST OS 5118 new	LOCTITE® STYCAST OS 5119 new	LOCTITE® ABLESTIK 3119	LOCTITE® ECCOBOND EO1016	LOCTITE® ABLESTIK BF 4	LOCTITE® ABLESTIK 2332	
🛡️ 保护材料							
EMI 电磁屏蔽/垫圈	LOCTITE SI 5421				LOCTITE SI 5822 new		
芯片底部填充胶	LOCTITE® ECCOBOND UF 1173	LOCTITE® ECCOBOND FP 4531	LOCTITE® ECCOBOND UF 8830S	LOCTITE® ECCOBOND UF 9000AG	LOCTITE® ECCOBOND UF 3711	LOCTITE® ECCOBOND UF 3713	LOCTITE® ECCOBOND FP 4535
密封保护	LOCTITE® SI 5088				LOCTITE® SI 5140		
🔥 导热材料							
导热垫片	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 3000	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 5000AP	BERGQUIST® GAP PAD®TGP 7000ULM BLU	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 10000ULM	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 12000ULM	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 18000SF new	BERGQUIST® GAP PAD® TGP 30000SF new
预固型导热凝胶	BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 10000						
双组分导热凝胶	LOCTITE® TCF 14001						
后固化导热凝胶	LOCTITE® BERGQUIST® TLF 12000CGEL new				LOCTITE® BERGQUIST® TLF 20000CGEL new		
相变化/硅脂	BERGQUIST® HI FLOW THF 5000UT		BERGQUIST® HI FLOW THF 5090PR new		LOCTITE® BERGQUIST® TGR 5000SF		

^{new} 新产品开发/即将量产

光模块产品组合—粘接材料

主动耦合与粘接胶

产品	技术	应用	关键属性	粘度 at 25°C (mPa·s)	玻璃化转变温度Tg (°C)	热膨胀系数 (ppm/°C)		固化种类	固化方法
				低于Tg	高于Tg				
LOCTITE® STYCAST OS 5106	环氧	主动耦合	▪ 单组份 ▪ 绝缘 ▪ UV+热双固化 ▪ 阴影部分可热固化 ▪ 高粘接力 ▪ 低CTE ▪ 低固化收缩率	54,000	99	18	47	UV + 热	UV 365 nm 热固120°C*60 min
LOCTITE® ECCOBOND UF 3711	环氧	主动耦合/ 边缘绑定	▪ 可纯UV固化 ▪ 高触变 ▪ 低CTE ▪ 低固化收缩率 ▪ 高Tg和模量	35,000	150	20	62	UV/ UV + 热	UV 365 nm 热固80-120°C
LOCTITE® ABLESTIK NCA 3216AC	环氧	主动耦合	▪ 快速UV固化 ▪ 高Tg & 低CTE ▪ 耐高温高湿 ▪ 对不同基材的优异粘接力 ▪ 稳定的点胶表现	21,450	134	29	116	UV + 热	UV 365 nm 热85°C*60 min
LOCTITE® 3217	环氧/丙烯酸酯	主动耦合	▪ UV+热双固化 ▪ 低模量带来较低的应力	37,600	82	53	178	UV + 热	UV 365 nm 热60°C*30 min
LOCTITE® ECCOBOND LUX 3042M	丙烯酸酯	主动耦合/组装	▪ 单组份 ▪ 双重固化系统 ▪ 在PEI塑料，FR4和多种基材上具有优秀的粘接力	85,000	114	87	174	UV + 热	UV + 120°C *30 min
LOCTITE® HHD 4042	环氧/丙烯酸	主动耦合/组装	▪ 单组份 ▪ 双重固化系统 ▪ 在PEI塑料，FR4和多种基材上具有优秀的粘接力	125,000	145	-	-	UV + 热	UV + 120°C *30 min

光模块产品组合—粘接材料

芯片粘接胶

产品	技术	应用	关键属性		粘度 at 25°C (mPa·s)	玻璃化转变温度Tg (°C)	导热率 (W/m·K)	固化种类	固化方法
LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMI	环氧	导电/导热	- 优异的导电/导热性能 - 低挥发 (满足NASA Outgassing & MIL-STD-883-5011挥发标准)	- 可以较低温度固化 (125°C可固化) - 室温下很长的操作时间 (2周)	30,000	103	2.4	加热	125°C*2 h / 150°C*1 h
LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMISR4	环氧	导电/导热	- 优异的导电/导热性能 - 低挥发 (满足NASA Outgassing挥发标准)	- 点胶工艺稳定 - 可靠的粘接力	8,000	120	2.5	加热	175°C*1 h / 150°C*2 h
LOCTITE® ABLESTIK 84-1LMISR9 NEW	环氧	导电/导热	- 优异的导电/导热性能 - 可低温固化, 100°C或低至 85°C固化温度	- 低挥发 - 低树脂析出	10,000	120	>2	加热	100°C*2 h / 85°C*>2 h
LOCTITE® ABLESTIK 2030SCR	丙烯酸酯	导电/导热	- 可快速固化 - 低模量 (1514MPa) 带来低应力	优异的导电导热表现	15,000	-	2	加热	Snap cure: 120°C*120 s/ 150°C*10 s
LOCTITE® ABLESTIK QMI 529HT	双马来酰亚胺/ 丙烯酸酯	导电/导热	- 优异的导电导热表现 - 耐湿热 - 稳定可靠的粘接表现	较低的模量带来较低的应力	18,500	3.3	6.5	加热	185°C*30 min
LOCTITE® ABLESTIKABP 6395TC	环氧	导电/导热	- 高导热 - 稳定操作性和较长的开放时间	- 低树脂析出RBO表现 - 对Ag, Cu & PPF优异的粘接力	11,500	55	30	加热	175°C*60 min/ 200°C*30 min
LOCTITE® ABLESTIK 8068TH	环氧	导电/导热	- 无压烧结银材料 - 稳定操作性和较长的开放时间	- 低树脂析出RBO表现 - 低应力	13,500	8.7	150	加热	200°C*90-120 min, N ₂ 烘箱
LOCTITE® ABLESTIK ABP 8920TCNP	双马来酰亚胺	绝缘导热	- 电绝缘 - 优异导热表现	- 优异MSL表现 - 稳定粘接力	15,000	44	3	加热	175°C*60 min
LOCTITE® ABLESTIK 84-3	环氧	绝缘导热	- 电绝缘 - 室温下很长的操作时间 - 稳定可靠性的粘接力		50,000	85	0.8	加热	150°C*60 min
LOCTITE® ECCOBOND ABLESTIK 2025DNP	丙烯酸酯 杂化体系	绝缘导热	- 出色的RBO树脂析出表现 - 耐260°C回流 - 稳定可靠性的粘接力		13,500	固化后: -35 Molding后: 36	0.3	加热	175°C*15 min
LOCTITE® ABLESTIKTE 3530	环氧	绝缘导热	- 较高的导热系数 - 低粘度 - 低温固化		60,000	55	2.3	加热	100°C*30 min/ 120°C*20 min/ 150°C*15 min

NEW 新产品开发/即将量产

光模块产品组合—粘接材料

光路胶

产品	技术	应用	关键属性
LOCTITE® STYCAST OS 5151 ^{NEW}	环氧	光学元件粘接	▪ 折射率RI: 1.51 @ 589 nm ▪ 低挥发 ▪ 通信波段高透过率 (>90% @ 1310 nm) ▪ 稳定可靠性的粘接力 ▪ 耐260°C回流

结构胶

产品	技术	应用	关键属性
LOCTITE® STYCAST OS 5118 ^{NEW}	环氧	结构粘接	▪ 精确控制的胶厚BLT ▪ 低树脂析出 ▪ 稳定可靠的粘接力 ▪ 低挥发
LOCTITE® STYCAST OS 5119 ^{NEW}	环氧	结构粘接	▪ 低树脂析出 ▪ 同类产品中极佳的柔韧性 (12%断裂伸长率) 和低应力 ▪ 稳定可靠的粘接力 ▪ 低挥发
LOCTITE® ABLESTIK 3119	环氧	结构粘接	▪ 低温固化 ▪ 在多种基材上有着优秀的粘接力 ▪ 非常低的收缩
LOCTITE® ECCOBOND EO1016	环氧	结构粘接	▪ 稳定可靠的粘接力 ▪ UL94-V0阻燃等级 ▪ 室温下优异的稳定性
LOCTITE® ABLESTIK BF 4	环氧	结构粘接	▪ 低挥发 ▪ 低吸水和湿气透过 ▪ 高Tg和模量 ▪ 电绝缘
LOCTITE® ABLESTIK 2332	环氧	结构粘接	▪ 同类产品中极佳的柔韧性 (12%断裂伸长率) 和低应力 ▪ 稳定可靠的粘接力

^{NEW} 新产品开发/即将量产



粘度 at 25°C (mPa·s)	玻璃化转变温度Tg (°C)	热膨胀系数 (ppm/°C)		固化种类	固化方法
低于Tg	高于Tg				
2,400	130	66	-	UV + 热	UV 365 nm 热120°C*60 min
47,000	147	40	156	加热	150°C*30 min
69,800	100	-	-	加热	120*60 min
7,000-23,000	110	65	210	加热	100°C*60 min/ 75°C*120 min
58,000	126	46	140	加热	150°C*20 min/ 93°C*24 h
23,500	94	32	87	加热	100°C*30 min
65,000-85,000	105	100	-	加热	100°C*90 min/ 120°C*30 min/ 150°C*20 min

光模块产品组合—保护材料

EMI 电磁屏蔽/垫圈

产品	技术	应用	关键属性
LOCTITE® SI 5421	有机硅	粘接/垫圈	- 导电RTV硅酮 - EMI/RFI屏蔽外壳的粘结和垫圈
LOCTITE® SI 5822 NEW	有机硅	粘接/垫圈	- 导电RTV硅酮 - EMI/RFI屏蔽外壳的粘结和垫圈

芯片底部填充胶

产品	技术	应用	关键属性
LOCTITE® ECCOBOND UF 1173	环氧	芯片底填-底部填充	- 低CTE，高Tg底部填充材料，适用于极端的温度循环条件 - 低挥发，满足NASA Outgassing
LOCTITE® ECCOBOND FP 4531	环氧	芯片底填-底部填充	- 低CTE，高Tg底部填充材料，适用于极端的温度循环条件 - 低挥发，满足NASA Outgassing
LOCTITE® ECCOBOND UF 8830S	环氧	芯片底填-底部填充	- 封装级底填材料 - 适用于非常小的pitch/bump size应用场景
LOCTITE® ECCOBOND UF 9000AG	环氧	芯片底填-底部填充	- 封装级底填材料 - 适用于非常小的pitch/bump size应用场景
LOCTITE® ECCOBOND UF 3711	环氧	芯片底填-边缘绑定	- 可纯UV固化 - 高触变 - 低CTE - 低固化收缩率 - 高Tg和模量
LOCTITE® ECCOBOND UF 3713	环氧	芯片底填-边缘绑定	返修和可靠性的完美平衡
LOCTITE® ECCOBOND FP 4535	环氧	芯片底填-边缘绑定	低CTE带来高可靠性，适用于极端的温度循环条件

防尘防水密封

产品	技术	应用	关键属性	粘度 at 25°C (mPa·s)
LOCTITE® SI 5088	有机硅	防尘防水密封	- UV+湿气固化 - UV快速预固定 - 阴影部分可湿气固化	50,000-80,000
LOCTITE® SI 5140	有机硅	防尘防水密封	室温湿气固化	30,000-140,000

NEW 新产品开发/即将量产



粘度 at 25°C (mPa·s)	玻璃化转变温度Tg (°C)	固化种类	固化方法
膏状	-	湿气固化	23 ±2°C/50 ±5% RH60 min表干
61,000	-	加热	120°C*1 h

粘度 at 25°C (mPa·s)	热膨胀系数 (ppm/°C) 低于Tg 高于Tg	玻璃化转变温度 Tg (°C) by TMA	室温下适用期	固化种类	固化方法
7,500	26 103	160	2天	加热	150°C*5 min
10,000	28 104	161	1天	加热	160°C*7 min
22,120	25 100	118	-	加热	150°C*2 h
11,930	19 62	135	-	加热	150°C/160°C*2 h
35,000	20 62	150	3天	UV/ UV + 热	UV 365 nm 热固80-120°C
11,600	32 115	133	>1天	加热	125°C*30 min
155,600	19 81	147	1天	加热	125°C*20 min/ 150°C*7 min

硬度Shore A	断裂伸长率 (%)	拉伸强度 (MPa)	固化种类	固化方法
≥25	≥135	≥1	UV + 湿气	UV 40 mW/cm²*60 s + RT*7天 @ 23 °C/50±5 % RH
30	200	1.8	室温湿气固化	RT*7天 @ 23 °C/50±5 % RH

光模块产品组合—导热材料

导热垫片

产品	技术	应用	关键属性	厚度 (mm)	邵氏硬度	导热系数 (W/m·K)
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 3000	有机硅	导热垫片	- 导热系数：3.0 W/m·K - 高顺应性，低压缩应力 - 玻璃纤维增强，抗剪切和撕裂	0.508-3.175	Shore 00 15	3.0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 5000AP	有机硅	导热垫片	- 一面带粘性，和界面很好的贴合可以降低界面热阻 - 低组装压力下也能实现较低的热阻 - 玻璃纤维增强，抗剪切和撕裂	0.508-3.175	Shore 00 35	5.0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 7000ULM BLU	有机硅	导热垫片	- 高导热，超柔软GAP PAD - 低渗油	0.508-3.175	Shore 000 70	7.5
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 10000ULM	有机硅	导热垫片	- 高导热，低压缩应力 - 低模量	1.016-3.175	Shore 000 75	10
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 12000ULM	有机硅	导热垫片	- 高导热，低压缩应力 - 低模量	1.016-3.175	Shore 000 68	12
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 18000SF NEW	非硅体系	导热垫片	- 非硅体系，不含硅氧烷 - 高导热 - 电绝缘 - 低渗油	0.508-3.175	Shore 00 85	18
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 30000SF NEW	非硅体系	导热垫片	- 非硅体系，不含硅氧烷 - 导热高达30 W/m·K - 非电绝缘 - 低渗油	0.508-3.175	Shore 00 66	30
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 40000SF	非硅体系	导热垫片	- 非硅体系，不含硅氧烷 - 导热高达40 W/m·K - 非电绝缘 - 低渗油	0.508-3.175	Shore 00 85	40

光模块产品组合—导热材料

导热凝胶

产品	技术	应用	关键属性	邵氏硬度	最小BLT胶厚 (um)	导热系数 (W/m·K)	固化种类	固化方法
BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 10000	有机硅	预固型导热凝胶	- 高导热，低热阻 - 温循可靠性 - 点胶工艺稳定 - 低应力	-	-	10	预固化型	-
LOCTITE® TCF 14001	有机硅	双组分后固化导热凝胶	- 高导热，低热阻 - 不同条件下的老化可靠性 - 间隙变化容差性高 - 稳定的粘接 - 低应力	Shore 00 62	-	14	室温	室温25°C*24 h/ 85°C*2 h
LOCTITE® BERGQUIST® TLF 12000CGEL NEW	有机硅	单组份后固化导凝胶	- 高导热，低热阻 - 低渗油，低挥发以及不同老化条件下高可靠性 - 点胶工艺稳定 - 稳定胶厚BLT控制	Shore 00 78	≤200	12	加热	85/100°C*1 h
LOCTITE® BERGQUIST® TLF 20000CGEL NEW	有机硅	单组份后固化导凝胶	- 高导热，低热阻 - 低渗油，低挥发以及不同老化条件下高可靠性 - 点胶工艺稳定 - 稳定胶厚BLT控制	Shore 00 77	≤250	20	加热	85/100°C*2 h, 或125°C*30 min

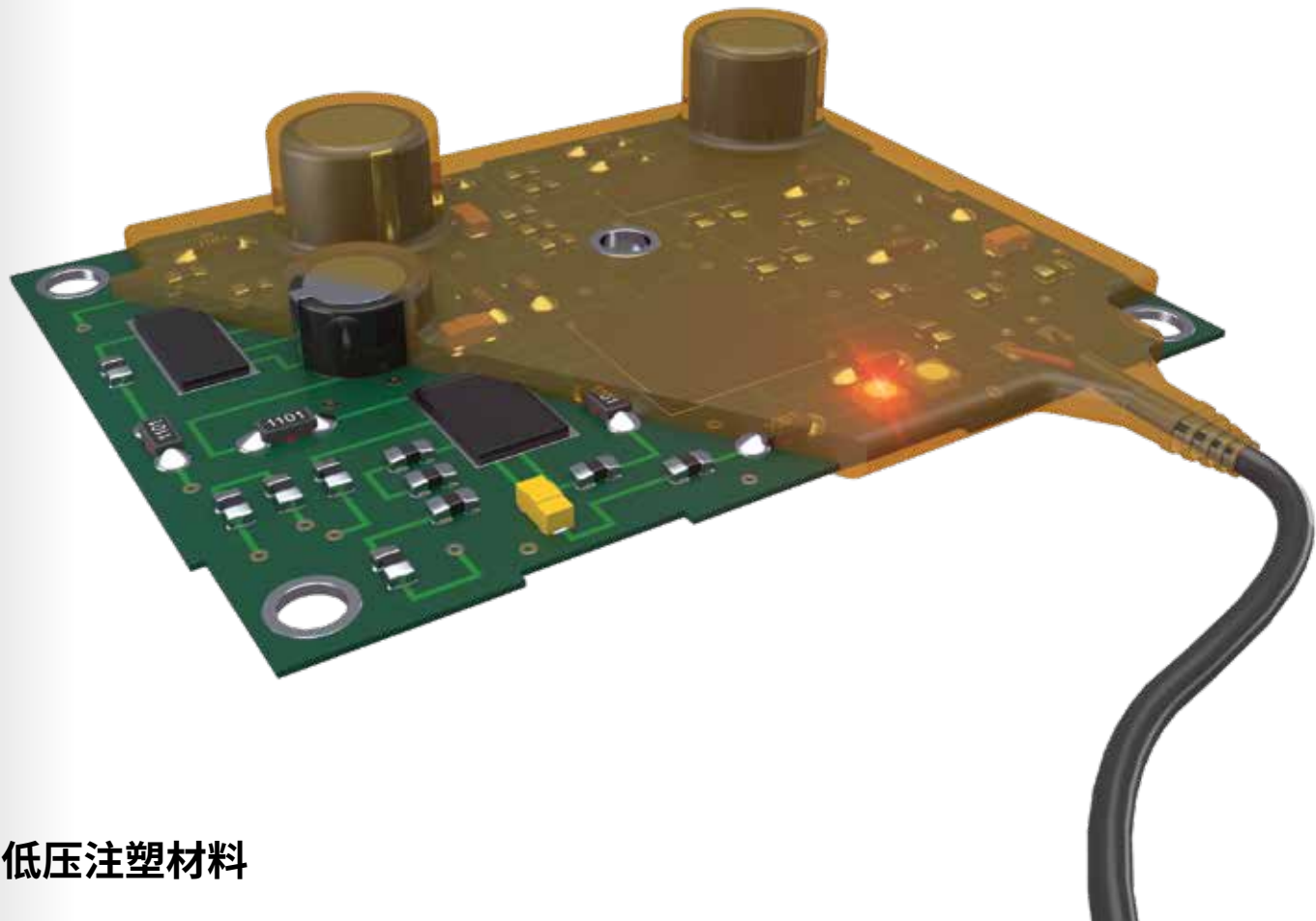
相变化/硅脂导热材料

产品	应用	材料厚度 (mm)	相变材料熔点 (°C)	最小BLT胶厚 (um)	热阻K*cm²/W	导热系数 (W/m·K)
BERGQUIST® HI-FLOW THF 5000UT	易于返工的相变材料，适用于各类型电子元器件及散热器之间的填隙需求，不需要预烘烤。	0.2, 0.25, 0.3, 0.4	45	25	0.105 @ 10 psi 0.09 @ 30 psi	5.3 (基于ASTM D5470测试方法) 8.5 (基于调整过的ASTM D5470测试方法)
BERGQUIST® HI-FLOW THF 5090PR NEW	低泵出，易于返工的相变材料，适用于各类型电子元器件及散热器之间的填隙需求。	0.2, 0.25, 0.3	-	25	0.11 @ 30 psi 0.10 @ 50 psi	-
LOCTITE® BERGQUIST® TGR 5000SF	具有非常低热阻的非硅导热材料，适合自动化点胶，具有优异的稳定性，适用于各类型电子元器件及散热器之间的填隙需求。	-	-	17	0.067 @ 10 psi 0.056 @ 40 psi	4.3 5.3 (烘烤后)

NEW 新产品开发/即将量产

线缆与连接器材料 解决方案

线缆与连接器材料 解决方案



低压注塑材料

TECHNOMELT® AS 5376	TECHNOMELT® PA 2035 / PA 2035 BLACK	TECHNOMELT® PA 6208N / PA 6208 BLACK
TECHNOMELT® PA 633N / PA 638 BLACK	TECHNOMELT® PA 641 / PA 646 BLACK	TECHNOMELT® PA 653 / PA 658 BLACK
TECHNOMELT® PA 668 WHITE	TECHNOMELT® PA 673N / PA 678 BLACK	

光模块产品组合—低压注塑材料

低压注塑材料

产品	技术	操作温度 (°C)	软化点 (°C)	低温柔韧性 (°C)	应用温度 (°C)	硬度硬度 (20°C)	断裂伸长率 (%)	粘度 (210°C 下的m·Pas)	备注
TECHNOMELT® PA 6208N / PA 6208 BLACK	聚酰胺	-40 bis +100	155 ± 5	-37	+190 bis +210	Shore A 82	450	3.200 ± 800	良好的附着力
TECHNOMELT® PA 653 / PA 658 BLACK	聚酰胺	-40 bis +100	155 ± 5	-50	+190 bis +210	Shore A 77	400	4.500 ± 1000	耐水解性能
TECHNOMELT® PA 633N / PA 638 BLACK	聚酰胺	-40 bis +130	175 ± 5	-30	+200 bis +240	Shore A 90	300	3.700 ± 800	UL94-V0(638型号)
TECHNOMELT® PA 641 / PA 646 BLACK	聚酰胺	-40 bis +130	175 ± 5	-35	+200 bis +240	Shore A 92	650	7.000 ± 2000	UL94-V0阻燃等级， 对PVC具有良好的粘接性
TECHNOMELT® PA 673N / PA 678 BLACK	聚酰胺	-40 bis +140	185 ± 5	-40	+210 bis +240	Shore A 90	400	3.000 ± 800	通用性强，加工性能良好
TECHNOMELT® PA 2035 / PA 2035 BLACK	聚酰胺	-20 bis +150	200 ± 5	-20	+240 bis +250	Shore D 42	500	5.000 ± 2000	UL94-V0 (2035黑色型号)
TECHNOMELT® PA 668 WHITE	聚酰胺	-30 bis +100	155 ± 5	-25	+190 bis +210	Shore A 90	600	7.000 ± 1000	白色，耐紫外线
TECHNOMELT® AS 5376	聚烯烃	-30 bis +90	141 ± 6	-35	+180 bis +200	Shore A 44	—	2.000 ± 800	广泛的粘接适用范围



中国

汉高亚太区及中国总部

上海市杨浦区

江湾城路99号尚浦中心7号楼

邮编：200438

电话：400-821-2567

传真：+86 21-2891-8971